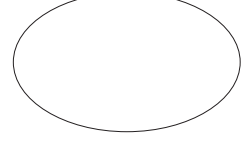
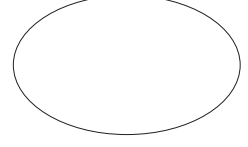
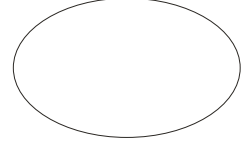
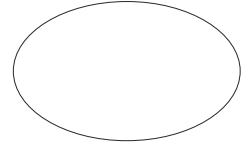
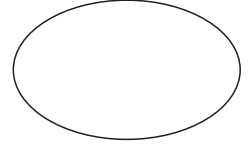
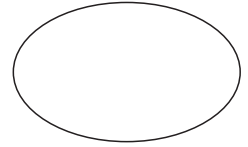


HY600系列 导热界面材料

HY600 Series Thermal Interface Material

专为电子零部件降温设计的导热界面材料
Special Design for Electronic Components Heat Transfer






项 目 Items	HY610	HY620	HY630	HY650	单位 Unit
颜色 Color	金色 Gold	金色 Gold	金色 Gold	金色 Gold	No
热传导系数 Thermal Conductivity	>3.05	>3.34	>3.57	>3.76	W/m-K
热阻抗 Thermal Impedance	<0.073	<0.051	<0.038	<0.018	°C-in ² /W
比重 Specific Gravity	>2.48	>2.57	>2.61	>2.68	g/cm ³
粘度 Viscosity	1000	1000	1000	1000	No
浓度 Thixotropic Index	380±10	380±10	300±10	300±10	1/10mm
瞬间耐温度 Moment Bore Temperature	-50~280°C	-50~280°C	-50~280°C	-50~280°C	°C
工作温度 Operation Temperature	-30~240°C	-30~240°C	-30~240°C	-30~240°C	°C



成份 Ingredients

矽化合物 Silicone Compounds	30%	25%	20%	15%	%
碳化合物 Carbon Compounds	20%	20%	20%	20%	%
氧化金属化合物 Metal Oxide Compounds	50%	55%	60%	65%	%
包 装 Package	ST	SP	TU	CN	Other
	软管	迷你包	针管	罐装	吊卡
	20g~25g	0.5g~5g	0.5g~30g	30g~1000g	0.5g~5g

产品图片 Products Pictures

ST	SP	TU	CN	Other
				

※本产品耐温，不自燃，一般室温储存方式即可。

Thermal Interface Materials, Non-Spontaneous In room Temperature

以上数据由深圳市华能智研电子有限公司实验室测试所得，该实验室保留最终解释权。

All data above provide by Shenzhen Halnziye Electronics Co.,Ltd. Halnziye All Rights Reserved